

广东富信科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <u>视频电话会议</u>	
参与单位名称及人员姓名	2024年9月12日 全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	投资者网上提问
	2024年9月14日 (现场参观)	东北证券：陈敏佳
地点	公司会议室	
公司接待人员姓名	1、董事长、总裁：刘富林 2、董事、副总经理：洪云 3、财务总监：刘淑华 4、董事会秘书：田泉 5、证券事务代表：霍莹敏	
投资者关系活动主要内容介绍	机构与高管问答交流 问 1: 请问应用于 800G 的 Micro TEC 今年能产生效益吗? 答：应用于数通 400G/800G 高速率光模块的 Micro TEC 目前处于小批验证阶段。 问 2: 今年市场行情差，股价低迷，请问公司是否考虑继续回购公司股份? 答：公司的回购方案正在推进，在回购期限内会根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。	

问 3: 在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会, 富信科技董事长、总经理刘富林回答, 公司 Micro TEC 送样验证进度取决于下游光模块厂商供应链国产化的诉求, 预计今年内能完成验证并实现小批供货, 2024 年光模块业务收入及利润将实现同比显著增长。请问现在 400G 高速光模块产品是否有最新进展, 另外今年的可穿戴空调产品销量如何?

答: 应用于数通 400G/800G 高速率光模块的 Micro TEC 目前处于小批验证阶段。公司可穿戴空调产品仍处于研发推广阶段, 今年对公司营收的影响较小。

问 4: 公司坏账计提的原则是什么, 目前应收越来越多, 怎么规避坏账风险?

答: 公司根据企业会计准则, 以单项或应收款项的账龄为信用风险特征划分组合, 对应收账款预期信用损失进行测试及计提减值准备。公司 2024 年上半年应收账款随着销售规模的扩大而增加, 在应收账款控制方面, 公司在交易前对客户进行信用评估, 建立信用档案, 制定合理的信用政策来预防风险; 同时加强合同管理, 确保合同条款明确, 对超过信用期限的应收账款进行特别关注, 并采取适当的催收措施。

问 5: TEC 相比国外竞争对手, 公司的核心优势是什么, 与竞争对手相比, 公司的不足及需要加强的地方是什么?

答: 对于性能、尺寸及可靠性要求较高的 Micro TEC 来说, 需要经过长时间的研发测试和技术积累才能达到相应的性能指标要求, 且产业化生产又需要足够的高端自动化设备、精密加工设备和熟练技术工人, 公司生产的 Micro TEC 产品已与国外友商同类产品处于同一水平区间。公司将不断研发新技术、新工艺、新装备, 依靠自身完善的管理体系和丰富的制造经验在关键核心技术上实现突破。

问 6: 海外业务市场情况怎样? 开发海外业务有什么机会? 预计下半年、明年会怎样?

答: 2024 年上半年, 公司海外业务的销售收入同比增长 11.54%。全球经济复苏面临诸多挑战, 公司始终坚持开发海

外市场，采取积极措施以适应新常态，并寻求增长机会。

问 7: 目前 400/800g 光模块 tec 进展怎样了? ABC 样处于哪个阶段? 今年会通过验证吗?

答: 应用于数通 400G/800G 高速率光模块的 Micro TEC 验证周期较长, 一般需要 6 个月以上。公司目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发, 处于小批验证阶段, 验证进度取决于下游光模块厂商供应链国产化的诉求, 力争今年内通过验证。后续如有进展, 相关信息会在定期报告和对外公告中及时披露。

问 8: 公司上半年销售增长主要来源于赊销, 怎么控制应收款?

答: 2024 年上半年, 公司紧抓市场需求回暖的有利时机, 灵活调整产品结构和经营策略, 覆铜板及陶瓷基板、热电器件、热电系统、热电整机产品的销售收入均实现增长。在应收账款控制方面, 公司在交易前对客户进行信用评估, 建立信用档案, 制定合理的信用政策来预防风险; 同时加强合同管理, 确保合同条款明确, 对超过信用期限的应收账款进行特别关注, 并采取适当的催收措施。

问 9: (1) 公司半年度计提减值损失 500 余万元, 主要源自哪部分? 整机还是电器? (2) micro tec 商业化进展情况? 产能利用率如何? 在手订单情况如何? (3) 是否已有进入车企激光雷达供应链并有商业化订单?

答: (1) 公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备合计 586.74 万元, 其中计提应收账款 229.26 万元, 其他应收款转回 3.48 万元, 合计计提信用减值损失金额 225.78 万元; 计提存货减值损失金额 360.96 万元, 主要是计提整机产品的存货减值。

(2) 公司应用于 5G 网络中光模块温控的 Micro TEC 已在多家头部企业实现批量供货, 在手订单稳定; 应用于数通

	<p>400G/800G 高速率光模块的 Micro TEC 目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发，处于小批验证阶段。</p> <p>(3) 公司已通过 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，并积极开展车载激光雷达应用 TEC 控温方案的研发，目前尚未进入车企激光雷达供应链，也未有商业化订单。</p> <p>问 10：请问公司 TEC 产品有哪些技术壁垒？</p> <p>答：（1）材料技术壁垒：公司是目前行业内为数不多的同时掌握碲化铋基半导体材料区熔、热压、热挤压三种制备技术的企业。其中，区熔工艺是比较传统的制备技术，无论是“配方”还是制备工艺，行业内大多数企业都相差不大。而热压技术，特别是热挤压技术作为相对先进的热电材料制备技术，只被少数企业所掌握。</p> <p>（2）制备工艺壁垒：半导体热电材料和热电器件的生产装配过程对制备工艺、生产设备、生产环境等都有较为严格的要求。对于性能、尺寸及可靠性要求较高的高性能微型热电器件来说，需要经过长时间的研发测试和技术积累才能达到相应的性能指标要求，而产业化生产又需要足够的高端自动化设备、精密加工设备和熟练技术工人，这对行业外企业在短时间内成功研发并生产性能符合要求的半导体热电器件增加了更大的难度。</p> <p>（3）生产设备壁垒：公司所处精细化行业，目前尚未有专门为热电行业创造高端自动化设备，公司通过自制和外购设备，根据产品所需调整各种工艺参数，配备特殊设计的工装制具，从而保证产品质量的稳定性和一致性。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无